



Flux de brasage OSPI 3311

INTERFLUX®
ELECTRONICS N.V.



Fiche technique OSPI 3311

Ver. 3.01 30-06-14

Page 1

Flux de brasage sans nettoyage pour l'OSP

Description:

Interflux® **OSPI 3311** est un flux sans nettoyage spécialement développé pour le brasage des circuits avec la finition OSP (cuivre passivé).

La plupart des finitions OSP se dégradent très vite après la refusion, ce qui rend le mouillage et les remontées d'alliage avec le brasage à la vague ou le brasage sélectif un vrai défi, certainement avec les alliages sans plomb.

Le flux **OSPI 3311** a été développé afin d'améliorer la brasabilité et les remontées d'alliage sur ces finitions OSP dégradées, même avec des vitesses de production élevées.

En plus, le flux est absolument sans halogènes et il a été développé pour être fiable.

Le flux OSPI 3311 est conforme aux exigences IPC.

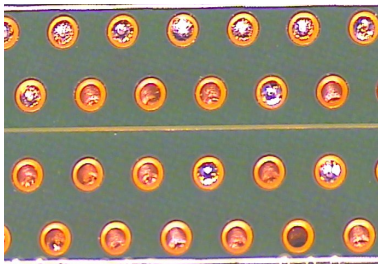


La photo n'est pas contractuelle

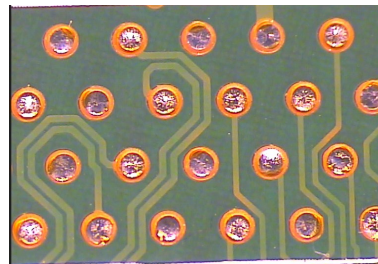
Propriétés chimiques et physiques

Apparence	Liquide incolore
Matière solide	7% +/- 1%
Densité à 20°C	0.823g/ml ±0.005
Indice d'acide	50-70 mg KOH/g
Odeur	Alcool
IPC/EN	OR/L0

Remontées d'alliage



Flux standard



OSPI 3311

Circuits OSP, brasés à 1,6m/min sur une vague SnCu après 2x refusions et 24hrs.



RoHS
compliant
2002/95/EC

Informations complémentaires:

Remontées d'alliage	1
Application du flux	2
Préchauffage et contact vague(s)	2
Tests de fiabilité	2
Conditionnement	3

Avantages:

- Très bonne brasabilité sur l'OSP dégradé
- Approprié pour des grandes vitesses de production
- Absolument sans halogènes
- Brasage avec plomb et sans plomb



Application du flux

Il y a des moyens différents pour appliquer le flux :
Fluxeur mousse, fluxeur spray, immersion, ...
Avec le fluxeur spray, c'est important d'avoir une **dépose** homogène du flux **sous le circuit**. Nous vous conseillons d'utiliser un spray qui fluxe la carte à l'aller et au retour. La vitesse de la buse du fluxeur doit être adaptée à la vitesse du convoyeur **afin** que chaque point **du circuit** soit fluxé deux

fois (une fois de chaque côté). Utilisez un carton, en lieu et place d'une carte, pour vérifier l'homogénéité du dépôt de flux. Une bonne **remontée** du flux dans les trous métallisés est également très importante. Il faut que le flux arrive jusqu'au dessus des trous. La pression d'air et la quantité correcte de flux sont des paramètres significatifs. Pour vérifier, on peut utiliser un papier de fax, posé au dessus du circuit sans composants.

Pour minimiser la formation de **résidu**, c'est important de **définir** la quantité minimale de flux. Réduire la quantité de flux déposé jusqu'à ce que des défauts, typiquement causés par une quantité de flux trop basse, comme des courts circuits, stalactites, etc...apparaissent. Après, augmenter la quantité jusqu'à ce qu'ils disparaissent.

Préchauffage et contact vague(s)

Un préchauffage est utilisé pour limiter le choc thermique du circuit en contactant la vague et pour évaporer le solvant du flux. Le préchauffage peut influencer la montée de l'alliage dans les trous métallisés avec des circuits de grande masse thermique (Cu, composants,...). Plus de préchauffage peut améliorer les remontées de

l'alliage sur ces circuits. Le flux même n'a pas une limite minimale pour le préchauffage. Il est recommandé de limiter le temps au dessus de 180°C pour éviter de détruire le flux.

Le contact vague est déterminé par la profondeur d'immersion, l'angle et la vitesse du convoyeur. Plus de contact vague peut améliorer les remontées

de l'alliage. Faire attention de ne pas surchauffer le circuit ou les composants, ou d'inonder le circuit (immersion trop profonde).

En général, le temps de contact de la première vague est compris entre 1 - 2s et pour la deuxième vague entre 2 - 4s.

Résultats des tests de fiabilité

Conformes aux normes EN 61190-1-2(2002) et IPC J-STD-004A

Propriétés	Résultats	Méthodes
Chimique		
Classification du flux	OR L0	J-STD-004A
Miroir de cuivre	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Présence d'halogènes		
Chromate d'argent (Cl, Br)	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33 D
Spot test (F)	passé	J-STD-004 IPC-TM-650 2.3.35.1A
Quantité d'halogènes	0,00%	J-STD-004 IPC-TM-650 2.3.35C
Environnement		
Test SIR	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3B



Conditionnement:

Bidons en polyéthylène (HDPE) de :
10 litres, 25 litres et 200 litres

Nom commercial du produit : OSPI 3311 No-Clean Soldering Flux for OSP

CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

INTERFLUX® ELECTRONICS

Consultez la dernière version de ce document sur:

www.interflux.com/fr

Le document dans une autre langue?:

www.interflux.com